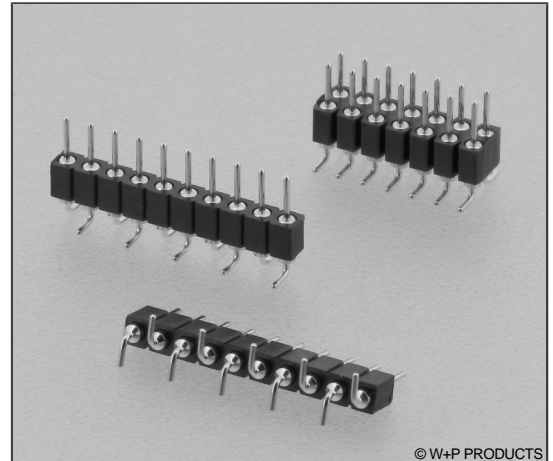


SMT-Präzisions-Stiftleisten RM 2,00mm, stehend, 1-/2-reihig SMT Precision Pin Headers, 2.00mm Pitch, Vertical, Single/Double Row

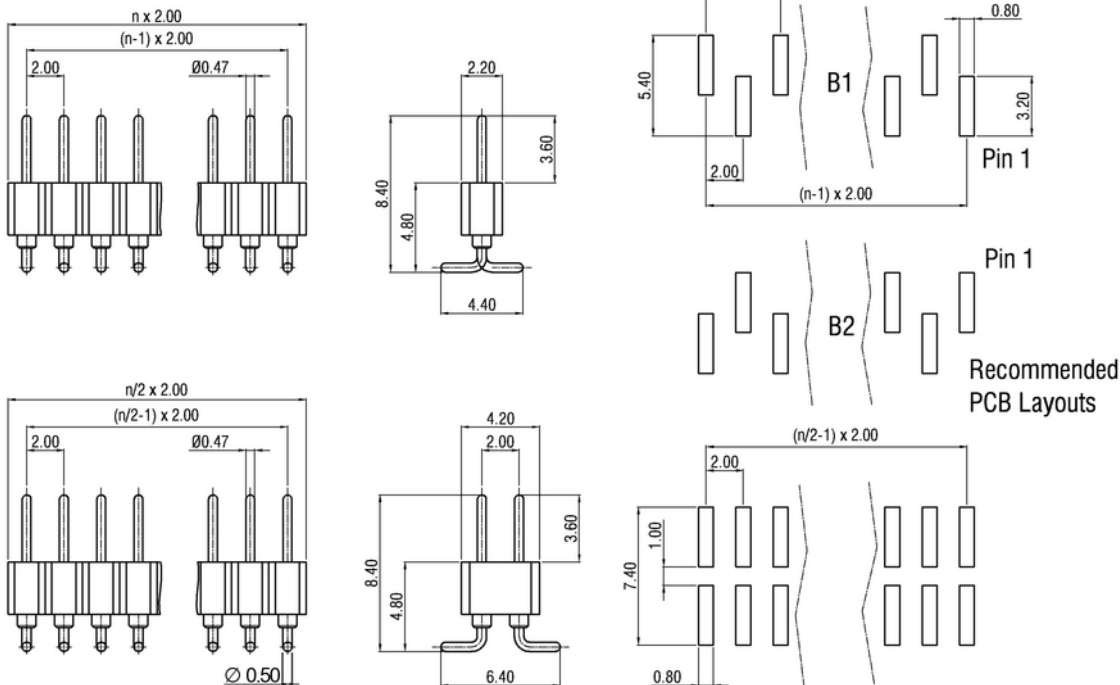
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Rundkontakt Ø0,47mm, Kupferlegierung
Contact Material	Ø0.47mm round contact, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
7452



Series	Contacts*	Rows*	Plating*	Packaging*
7354	050	11	10	PPST
	003-050 Einreihig Single row 004-100 Zweireihig Double row	11 Einreihig B1 Single row B1 12 Einreihig B2 Single row B2 20 Zweireihig Double row	10 0,25µm Gold 0.25µm gold plated 50 Verzinkt Tin plated	ST PPST PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

